

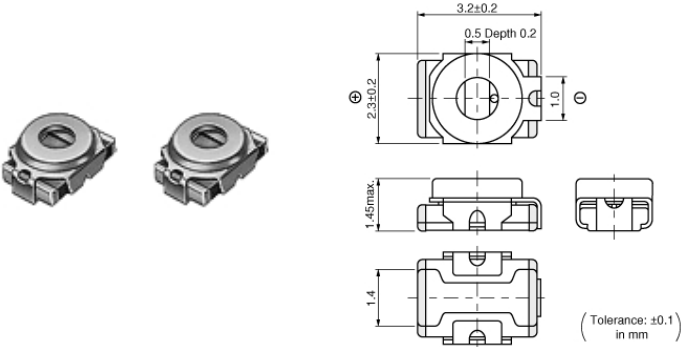
TZV2R200A110B00

已经停产

RoHS

REACH

外观&形状



特点

1. Small size with external dimensions of 2.3(W)x3.2(L)x1.45max.(H)mm.
2. Unique construction with no plastic material provides superior soldering heat resistance to maintain excellent characteristic performance after reflow soldering.
3. Designed for automatic placement in surface mount applications.
4. Funnel shaped metal case enables in-process automatic adjustment.

包装信息

包装	规格	标准包装数量
B00	散装袋	500

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

TZV2R200A110B00

规格

形状	SMD
工作温度范围	-25°C to 85°C
厚度	1.45mm
厚度公差	max.
额定电压	25Vdc
静电容量最小值(max.)	4.5pF
静电容量最大值	20pF
静电容量最大值公差	+100/-0%
调整方向	上方
温度特性	N750±500ppm/°C
Q	500min. at 1MHz, Cmax.
耐电压	55Vdc
绝缘电阻(min.)	10000MΩ
力矩	1.0 to 9.8mNm
质量	0.04g

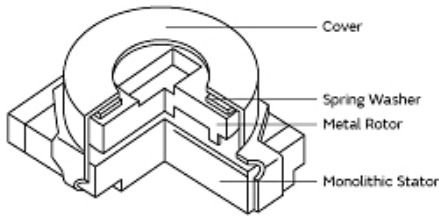
注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

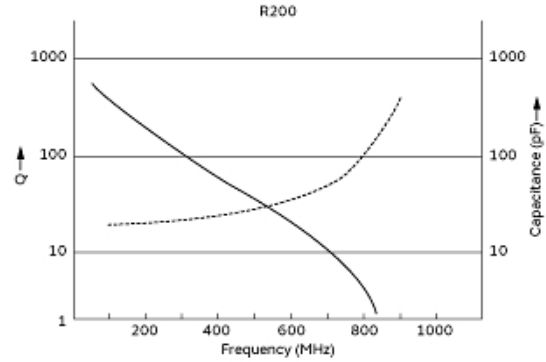
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

TZV2R200A110B00

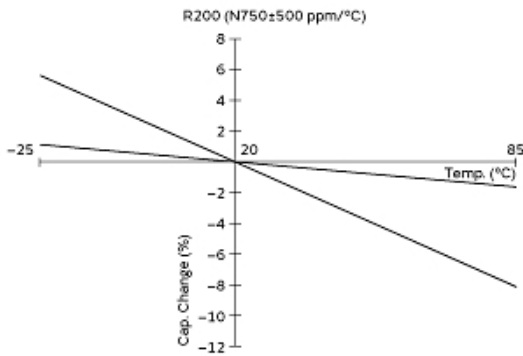
产品数据



结构



频率特性



温度特性

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。